

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260109

投资者关系 活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div>
---------------	---

	<p>增长 33%，同比增长 33%；半导体显示材料业务前三季度累计实现产品销售收入 4.13 亿元，同比增长 47%，第三季度实现销售收入 1.43 亿元，环比略增，同比增长 25%。</p> <p>核心产品增长主要驱动因素包含多维度核心优势叠加：一是 AI 产业快速发展驱动下游半导体芯片及高端显示面板需求持续增长，带动上游材料市场规模扩容，为公司半导体板块业务带来增量需求；二是公司在材料端的产品布局优化及与客户新产品线同步验证能力的增强，叠加技术升级带来的产品性能提升，显著抬高了产品弹性，进一步强化了市场竞争力。</p> <p>问 2：公司作为国内半导体材料领域的重要供应商，在 CMP 产品核心原材料自主制备的基础上，该环境是否为公司拓展国内及外资客户带来额外机遇？</p> <p>答：公司在供应链管理方面具备坚实的保障能力，已全面实现 CMP 抛光硬垫核心原材料的自主制备，能够确保相关产品生产供应的稳定性与连续性。同时，在 CMP 抛光液领域，公司拥有核心原材料——研磨粒子的自主供应优势，具备从研磨粒子开始定制化开发产品的能力，各类抛光液产品搭载自产研磨粒子的供应链优势明显，进一步强化了供应链安全保障水平。</p> <p>当前环境下，下游客户对供应链稳定性的重视程度显著提升，公司凭借稳定的产能供应、自主制备的原材料体系以及已在国内主流晶圆厂客户中建立的深度合作关系，有望进一步巩固现有市场份额。同时，公司与核心客户合作黏性高，一方面源于产品性能可精准匹配客户技术需求，另一方面依托快速响应的本地化服务能力，进一步巩固了合作基础。除此之外，公司 CMP 抛光垫产品已与更多外资本土及海外市场客户接洽推广中，供应链的稳定性与产品竞争力将助力公司更好地把握外资客户拓展机遇，为海外市场拓展奠定基础。</p> <p>问 3：公司在 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 领域占据国内供应领先地位，同时布局了无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）、黑色像素定义层材料（BPD L）等新产品。请说明公司显示材料业务的情况如何，以及新产品验证进展是否符合预期？该领域的业务增长是否具备持续性？</p> <p>答：公司在 OLED 新型显示材料领域具备较强的市场竞争力，YPI、PSPI 产品的供应领先地位持续稳固，客户主要覆盖国内主流 OLED 面板厂，建立了长期稳定的合作关系，客户黏性高；同时，显示材料作为 OLED 面板制造的高频耗材，复购属性强，为公司带来持续稳定的现金流。2025 年前三季度，公司半导体显示材料业务收入同比增长 47%，产能利用率维持在合理水平，仙桃产业园年产 1000 吨 PSPI 产线已投产并持续批量供应，年产 800 吨 YPI 二期项目作为新增产能补充，能够充分满足现有及潜在客户的订单需求。</p> <p>新产品方面，公司持续推进产品及品类拓展，无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）、黑色像素定义层材料（BPD L）等正按计划推进客户验证工作，目前验证进展符合预期。同时，公司快速推进 PI 取向液的产品开发，在客户端的验证已全面展开，多款新一代 OLED 显示材料的创新研发及送样验证，目标填补相关领域空白。</p>
--	--

问 4：请说明公司与核心客户的合作稳定性、订单续签情况，公司在未来有何具体目标及策略？

答：公司半导体业务与国内主流晶圆厂、OLED 面板厂等核心客户建立了深度合作关系，合作稳定性极强，相关订单续签情况良好，客户黏性高。从行业情况来看，国产品圆厂加速扩产，下游半导体与 OLED 显示面板行业景气度较高，客户产能利用率维持高位，部分核心客户已披露明确的扩产计划。产能扩张直接带动上游材料需求的增长，叠加公司产品国产化率提升的趋势，将为公司带来显著的增量订单机会，进一步放大技术升级带来的产品弹性优势。

未来在国内市场方面，持续深化与现有核心客户的合作，同步跟进其扩产项目，扩大产品供应品类与规模，进一步提升市场份额；同时，积极拓展其他主流晶圆厂、封测厂及显示面板厂客户，提升市场覆盖范围。海外市场方面，持续推进与更多外资本土及海外市场客户的接洽与推广，加速国际化布局进程，力争实现海外市场份额的稳步提升。

问 5：公司认为 2026 年半导体材料行业的核心发展机遇是什么？有哪些投入？

答：2026 年半导体材料行业的核心发展机遇主要包括：一是 AI 驱动下游半导体、OLED 显示面板行业持续发展，带动上游材料需求增长；二是全球半导体产业链供应链重构背景下，客户对供应链稳定性的需求提升，为可自主制备核心原材料的企业带来发展机会；三是大硅片、化合物半导体、先进封装等新兴领域的发展，打开了半导体材料的增量市场空间。

针对上述机遇，公司将依托各项核心优势制定针对性战略安排：业务布局方面，持续聚焦半导体创新材料核心板块，深化 CMP 相关材料、半导体显示材料业务优势，加快光刻胶、先进封装材料等新业务的产业化进程，推进产品及品类拓展；研发投入方面，保持研发投入规模，优化研发资源配置，重点突破新兴领域核心技术，提升产品迭代能力与产品弹性；市场拓展方面，国内市场提升市场份额，海外市场加速国际化布局；成本控制方面，持续推进降本控费专项工作，通过工艺优化、集中采购、精细化管理等方式提升运营效率，增强成本竞争力，同时依托高频耗材的复购属性保障现金流稳定。

问 6：公司一直保持着高研发投入，请具体说明各领域研发项目的阶段性成果的商业化转化预期？

答：2025 年前三季度，公司研发投入主要投向半导体板块的柔性显示材料、抛光液与清洗液、抛光垫和光刻胶等领域。阶段性成果及商业化转化预期如下：一是 CMP 抛光液领域，搭载自产氧化铈磨料的抛光液等新产品在客户端导入验证流程按计划推进，该业务与抛光垫形成协同效应，进一步完善 CMP 材料品类布局；二是半导体先进封装材料领域，临时键合胶、封装光刻胶已在已有客户持续规模出货，同时在国内各主流封测厂客户的验证导入持续进行，有望进一步扩大客户覆盖范围；三是高端晶圆光刻胶领域，该领域技术壁垒高，产品附加值高，公司具备显著技术优势，有数款重点型号在全力冲刺订单，潜江二期量产线计划转入试运行，后续计划逐步实现规模化量产与销售。上述新业务的产业化将持续丰富公司产品品类，同时依托高频耗材的复购属性，进一步增强公司现金流稳定性。

附件清单	无
日期	2026 年 1 月 8 日